

证券代码：002185

证券简称：华天科技

## 天水华天科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-01

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>投资者关系活动类别</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）  |
| <b>活动参与人员</b>      | 中粮资本：赵若冰、张高峰<br>公司接待人员：副总经理及董事会秘书常文瑛、证券部部长许腾旭、证券事务代表杨彩萍   |
| <b>时间</b>          | 2026年4月10日上午  |
| <b>地点</b>          | 公司子公司华天科技（西安）总部管理有限公司   |
| <b>形式</b>          | 现场交流  |
| <b>交流内容及具体问答记录</b> | <p>交流内容主要如下：</p> <p>1、公司目前主要生产基地及经营情况</p> <p>公司的主要生产基地有母公司天水和子公司西安、昆山、南京、江苏、Unisem、韶关和上海。天水基地以引线框架类产品为主，产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NOR Flash等。西安基地以基板类和 QFN、DFN 产品为主，产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。南京基地以存储器、射频、MEMS 等集成电路产品的封装测试为主。昆山基地封装晶圆级产品，主要产品包括 TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out 等。江苏基地以 Bumping、WLCSP 等晶圆级产品为主。Unisem 封装产品包括引线框架类、基板类以及晶圆级产品，主要以射频、汽车电子产品为主。韶关基地以引线框架类封装产品为主。上海基地主要开展晶圆测试和成品测试业务。</p> <p>2025 年，在集成电路行业快速发展的大背景下，公司订单同比大幅增长，各季度营业收入均实现正增长，并于四季度实现新高。全年实现营业收入 172.14 亿元，同比增长 19.03%，实现</p> |

归属于上市公司股东的净利润 7.11 亿元，同比增长 15.30%。

## 2、公司目前的市场地位及行业发展展望

公司自成立以来，经过二十余年发展已成为封装测试龙头企业之一，目前业务规模位列中国大陆前三、全球第六。

2025 年全球半导体行业运行呈现出更加健康、可持续的发展态势，行业复苏增长的基础进一步夯实。自 2024 年全球半导体市场进入新一轮复苏上行周期以来，2025 年延续并巩固增长趋势，尤其在人工智能、高性能计算、数据中心建设等需求的拉动下，存储电路市场价格大幅上升，市场需求持续强劲。根据相关统计数据，2025 年全球半导体销售额达到 7,917 亿美元，同比增长 25.6%，创历史新高。

展望 2026 年，人工智能、物联网等新兴技术以及机器人、新能源汽车、商业航天等产业的快速发展将持续推动集成电路需求快速增长，其中存储与逻辑电路产品仍为增长主力，增速或均超 30%。据预测，2026 年全球半导体销售额将持续攀升，有望达到约 1 万亿美元。

## 3、公司治理及管理团队方面

公司按照证监会、交易所出台的监管规定，建立了适应公司发展的治理架构，内部控制有效执行。去年 11 月份公司完成监事会改革，由董事会审计委员会承担监事会职责。目前董事会及高管成员均具备承担其职责的从业经验和管理能力，核心管理团队人员稳定。

## 4、公司研发投入以及重点的研发布局

公司重视集成电路封装技术和产品创新工作，不断加大研发投入，确定以 2.5D、存储、FOPLP、CPU/GPU/AI、CPO、汽车电

|   |   |
|---|---|
|   | <p>子等先进封装技术和封装产品为研发方向。近年来公司研发投入占营业收入的比例保持在 5%以上，2025 年公司研发投入 10.38 亿元，占营业收入比例为 6.03%。</p> <p>5、公司未来出海以及在并购方面的考虑</p> <p>公司在十余年前就考虑通过全球布局服务全球客户。2019 年，公司完成收购 Unisem 股份事项，并将 Unisem 纳入合并范围。后续，公司仍将积极寻找符合公司发展战略的并购项目，通过资源整合，不断提升公司封装技术水平，优化客户结构，提高市场份额，促进公司稳健发展。</p> <p>6、公司目前收购华羿微电的进展情况</p> <p>去年 9 月，公司启动了收购华羿微电事项，该收购事项已通过公司董事会和股东会审议，并获得深圳证券交易所受理。目前，相关工作正在积极推进中。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>             | <p>本次活动不涉及应披露的重大信息</p>  |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p> | <p>无</p>  |